

第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載 ハイエンドGPU×2枚搭載可能



画像処理・マシンビジョン向け ミドルタワー型PC
IPC-C622SPI-T



- 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載
- シングルCPU搭載で最大20コア搭載
※Gold 6230プロセッサ
- インテル® C622 チップセット装備
- 最大2TBメモリー(DDR4)搭載可能
- 10G LAN×2基、IPMI×1基を装備
- ハイエンドGPUボードを2枚搭載可能

☑ 長期供給の第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを選択可能

14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ」を搭載し、長期供給が可能なプロセッサを選択することができます。長期運用が想定される装置／システムへの組み込みに適しています。

☑ ハイエンドGPUが最大2基まで搭載可能

IPC-C622SPI-TはシングルプロセッサながらPCI Express x16シグナルのレーンが2本直結し、最大2基のハイエンドGPUを搭載可能にします。ハイエンドGPUはGeForce® RTX 2080(Ti)などが選択可能です。

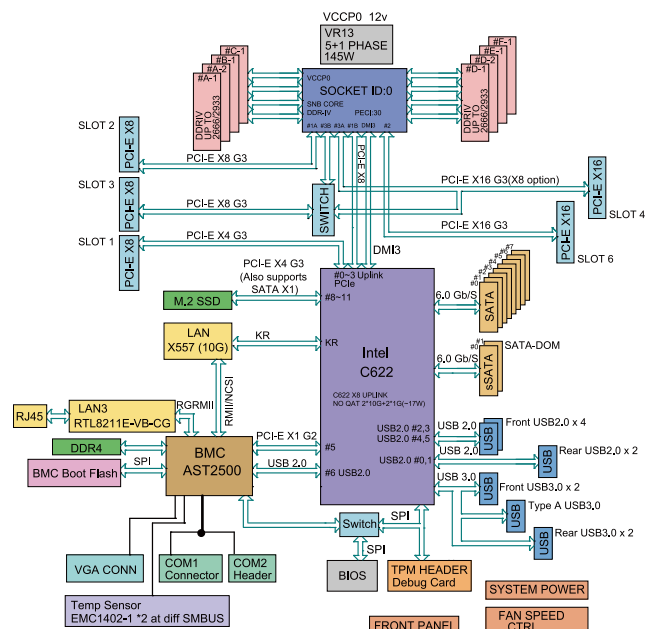
製品仕様

モデル	IPC-C622SPI-T	
プロセッサ	種類	第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ 【長期供給性 有】 Gold 6230 (20 コア 40 スレッド、2.10GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP125W) Gold 6226 (12 コア 24 スレッド、2.70GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP125W) Gold 5215 (10 コア 20 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.40GHz、TDP85W) Silver 4215 (8 コア 16 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.50GHz、TDP85W) 【長期供給性 無】 Gold 6234 (8 コア 16 スレッド、3.30GHz、ターボ・ブースト時 4.00GHz、TDP130W) Gold 6128 (6 コア 12 スレッド、3.40GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP115W) Gold 5222 (4 コア 8 スレッド、3.80GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP105W)
	搭載数	1
チップセット	インテル® C622 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz
	容量	標準 16GB (8GB × 2) ※最大 2TB
	スロット数	8
ストレージ	5 インチベイ	3
	3.5 インチベイ	内部 4 (空き 2) ※標準：システム用 480GB SSD × 1 (2.5 インチ変換マウントを使用。最大 2 台まで搭載可能) ※標準：データ用 1TB HDD × 1
	SATA コネクタ数	10 (SATA 3.0) (空き 8) ※標準：SSDx1、HDDx1 で使用
グラフィックス	Aspeed AST2500 BMC	
I/O	VGA	1
	シリアル (COM)	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0)、2 (USB2.0)
	LAN	2 (10GbE)
	IPMI	1
拡張スロット	SLOT7: None SLOT6: PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU 側) SLOT5: None SLOT4: PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16/x8 シグナル、CPU 側) SLOT3: PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、0/x8 シグナル、CPU 側) SLOT2: PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU 側) SLOT1: PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x4 シグナル、PCH 側)	
外形寸法	ミニタワー W198mm × D553mm × H425mm(突起物等を除く)	
重量	TBC	
電源	V-Series V1300 Platinum	
利用環境	入力電圧	AC90V ~ 240V
	温度	10°C ~ 35°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10°C ~ 55°C
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)

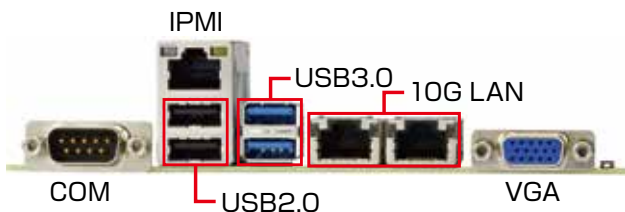
拡張スロット



ブロック図



I/Oポート



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間: 9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL: 03-5446-5535 mail: cto_sales@hpc.co.jp
WEBサイト: <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2020年1月現在の内容です。